

杭州长川科技股份有限公司（长川科技， 300604）（300604）

个股分析报告

行业：半导体器件专用设备制造

报告日期：2026 年 9 月 13 日

截至 2026 年 9 月 11 日收盘；技术指标及资金数据以研究纪要披露的相应日期和计算口径为准

本报告基于公开信息由 AI 自动整理生成，仅供参考，不构成投资建议

一、核心摘要

长川科技 2026 年上半年实现营业收入 34.61 亿元，同比增长 59.72%；归母净利润 9.64 亿元，同比增长 125.67%，扣非归母净利润 9.22 亿元，同比增长 158.11%，业绩预告基本兑现，收入与利润均延续高速增长。2025 年全年收入 52.92 亿元、归母净利润 13.31 亿元，分别同比增长 45.31%和 190.42%，公司业绩扩张和盈利弹性较为突出。

公司以测试机为核心、分选机为支柱，并向探针台及 AOI 等设备延伸。2025 年测试机收入 32.03 亿元，占比 60.53%，同比增长 55.29%，毛利率 62.25%；分选机收入 15.68 亿元，占比 29.64%，同比增长 31.76%，毛利率 41.34%。产品平台化布局、客户认证壁垒、国产替代和规模效应构成当前主要增长逻辑。

公司研发投入强度较高，2025 年研发投入 12.68 亿元，占收入 23.97%，研发人员占员工总数 52.28%，并拥有海内外专利超过 1,400 项。2026 年通过定向增发募集资金净额约 30.92 亿元，主要用于半导体设备研发和补充流动资金，同时完成长川制造少数股权收购及海外 PYXIS 相关布局，有助于扩充研发、产能和产品协同，但也带来股本摊薄、资金占用及项目收益释放滞后的考验。

截至 2026 年 9 月 11 日，股价为 257.70 元，市盈率 TTM 约 89 倍，估值处于较高水平；技术上股价低于 MA5、MA10 和 MA20，MACD 偏弱，主力资金当日净流出约 2.20 亿元，短线处于高波动、偏弱震荡状态。250~255 元区域为近期重要支撑，265~270 元及 275~286 元分别构成短线修复和进一步反弹的观察压力区。

二、公司概况

2.1 基本信息

项目	内容
股票代码	300604
成立时间	2008 年
上市时间	2017 年 4 月 17 日
主营业务	集成电路专用设备的研发、生产和销售，覆盖半导体后道测试及部分晶圆测试环节
2025 年营业收入	52.92 亿元，同比增长 45.31%
2025 年归母净利润	13.31 亿元，同比增长 190.42%
2025 年研发投入	12.68 亿元，占营业收入 23.97%
研发人员	2,330 人，占员工总数 52.28%
知识产权	截至 2025 年 12 月 31 日，拥有海内外专利超过 1,400 项，其中发明专利超过 400 项，软件著作权 162 项
2025 年收入地区结构	中国境内收入 44.74 亿元，占 84.55%；境外收入 8.18 亿元，占 15.45%
产能披露口径	年报按集成电路电子工业专用设备整体口径披露，未拆分测试机、分选机及 AOI 等产品的独立产能
2025 年产销与产能利	销售量 2,472 台，生产量 2,954 台，期末库存量 1,620 台，产能利用率

项目	内容
用率	82.79%；2024 年产能利用率为 96.35%
生产、研发及服务布局	在杭州、内江、上海、苏州、哈尔滨以及马来西亚等地形成生产、研发或服务布局；2025 年 5 月集成电路高端智能制造基地正式投入使用

2.2 主营业务与产品布局

测试机：数字测试机、数模混合测试机、模拟及功率测试机，面向 SoC、逻辑芯片、电源管理芯片等应用；2025 年收入 32.03 亿元，占营业收入 60.53%，同比增长 55.29%，毛利率 62.25%。

- 分选机：重力式、平移式、转塔式分选机，以及测试、分选、编带一体化设备和常温、高温、低温及三温测试分选设备；2025 年收入 15.68 亿元，占营业收入 29.64%，同比增长 31.76%，毛利率 41.34%。
- 探针台及相关设备：用于晶圆测试，是公司未来重点拓展方向之一。
- AOI 光学检测设备及其他产品：覆盖晶圆外观检测、封装外观检测、光学量测、检测及编带等一体化设备；其他产品还包括自动化设备、探针台及配件等，2025 年其他产品收入 5.20 亿元，占营业收入 9.83%，同比增长 33.86%，毛利率 52.09%。
- 产品结构：公司已由早期以分选机为主，逐步转向测试机为核心、分选机为重要支柱、AOI 及探针台等设备补充的平台化产品结构。测试机收入占比由 2024 年的 56.64%提升至 2025 年的 60.53%。
- 并购与产品扩展：2019 年收购新加坡 STI，切入 AOI 光学检测设备；2023 年完成对马来西亚 EXIS 的收购，补充转塔式分选机产品。

2.3 产业链上下游地位与成本利润结构

长川科技处于半导体设备产业链中游偏后端，向上承接电子元器件、精密机械、视觉检测及控制部件，向下服务晶圆制造、封装测试和芯片设计企业。公司以测试机为核心、分选机为支柱，并向探针台和 AOI 设备扩展，利润来源主要是研发技术、客户认证、产品协同及规模效应，而非低成本装配。

- 公司主要采购集成电路、继电器、连接器、电源、计算机等电子元器件；机械零件、导轨、电机、温控器等机械及运动控制部件；视觉系统、传感器、PCB 板等光学、检测和控制部件，并采购部分 PCB 板焊接、线缆焊接等外协加工服务。
- 2025 年直接材料成本 19.33 亿元，占主营业务成本 81.26%；直接人工成本 0.94 亿元，占 3.94%；制造费用 1.44 亿元，占 6.04%。按营业成本口径，直接材料占比为 89.86%。
- 2025 年前五大供应商采购金额 7.62 亿元，占年度采购总额 19.42%；单一最大供应商占采购总额 6.20%。年报未披露主要供应商名称，无法进一步判断对特定海外芯片、视觉系统或精密部件供应商的实质依赖。
- 采购采用框架协议、年度/季度/月度滚动预测和订单采购相结合的模式，原材料品类较多、供应商数量较为分散，公司对普通零部件具备一定替代能力。
- 公司并非大宗商品型成本结构，成本波动主要来自电子元器件、精密机械件、视觉系统和控制模块等采购价格。对普通零部件的议价能力相对有限，但可通过供应商筛选、批量采购及多供应商体系降低单一供应商风险；高性能芯片、精密运动控制、视觉检测和温控系统等关键部件仍可能存在供应链依赖。
- 下游客户主要包括晶圆制造企业、集成电路封装测试企业、芯片设计企业，以及功率器件、模拟芯片、SoC、存储和汽车电子等芯片厂商。
- 公司产品已获得长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微、日月光等客户使用和认可，部分产品实现对进口设备的替代。

- 2025 年前五大客户销售金额 30.51 亿元，占年度销售总额 57.66%；最大客户占 22.79%，第二大客户占 12.26%。2024 年前五大客户占比为 62.07%。上述数据来自 2025 年年度报告；客户以“客户一”等匿名方式披露，具体客户名称及业务稳定性无法由年报判断。
- 大型封测厂、晶圆厂和芯片企业通常具有严格的供应商认证、验收和付款流程。设备企业需要经历较长时间的产品验证、导入和售后服务，客户导入后具有一定黏性，但在新产品导入和大客户采购阶段，客户仍可能对价格、交付、验收及售后服务提出较强要求。
- 公司客户集中度较高，且下游需求受半导体资本开支、芯片库存和扩产节奏影响，收入和利润存在行业周期性。
- 截至 2025 年 12 月 31 日，公司应收账款和合同资产余额中前五名客户占 64.09%，2024 年同期为 62.00%，高于 2025 年收入端前五大客户 57.66%的销售占比，表明应收及合同资产在大客户端相对集中。公司年报未在本次核验资料中直接披露 2025 年应收账款周转天数，也未提供足够数据准确计算应收账款/营业收入比例，因此不作自行估算。该数据能够说明大客户回款和验收对营运资金存在影响，但不能单独证明公司缺乏议价能力，仍需结合回款周期、合同条款和账龄结构判断。
- 供应商端：2025 年前五大供应商采购占比 19.42%，最大供应商占 6.20%；客户端：2025 年前五大客户销售占比 57.66%，最大客户占 22.79%，第二大客户占 12.26%，客户集中度明显高于供应商集中度。客户及供应商均匿名披露，相关集中度数据主要来自 2025 年年度报告，具体名称及业务稳定性无法交叉判断。

年度	毛利率	净利率	简要说明
2022 年	约 52.75%	约 17.90%	营业收入 25.77 亿元，归母净利润 4.61 亿元。半导体设备景气度仍较高，测试机和分选机业务保持较好盈利，但研发投入及行业周期波动已影响利润弹性；毛利率数据主要来自公开财务数据库，建议以原始年报复核。
2023 年	约 57.10%	约 2.54%	营业收入 17.75 亿元，归母净利润 0.45 亿元。半导体行业处于下行周期，收入规模明显下降；公司维持较高研发投入，固定费用和研发费用对利润形成较大压制；毛利率数据主要来自公开财务数据库，建议以原始年报复核。
2024 年	54.85%	约 12.59%	营业收入 36.42 亿元，归母净利润 4.58 亿元。行业回暖、下游需求恢复及测试机放量推动收入增长，但分选机及其他产品毛利率较低，直接材料成本占比约 89%，产品结构和材料采购影响综合毛利率。测试机毛利率 66.61%，分选机毛利率 36.35%。
2025 年	55.05%	约 25.16%	营业收入 52.92 亿元，归母净利润 13.31 亿元。收入扩张带来规模效应，期间费用率下降，分选机产品结构改善；测试机毛利率为 62.25%，同比下降 4.36 个百分点，主要与测试机产品结构变化及部分模拟类产品占比提升有关；分选机毛利率为 41.34%，同比提升 4.99 个百分点。

公司位于半导体设备产业链中游偏后端，属于研发、客户认证和产品集成驱动的设备制造商，不是上游资源型高毛利企业，也不是普通低附加值装配企业。当前利润主要由高毛利测试机、客户认证壁垒、

产品协同和规模效应驱动；进一步改善利润率取决于高端测试机放量、分选机产品结构改善、国产替代份额提升、海外业务扩张以及新基地投产后的产能利用率提升。

三、财务数据与估值分析

3.1 近期经营业绩

报告期	营业收入	同比	归母净利润	同比
2026 年上半年	34.61 亿元	+59.72%	9.64 亿元（归属于上市公司股东）	+125.67%
2026 年一季度	13.78 亿元	+69.09%	3.53 亿元（归属于上市公司股东）	+217.60%
2026 年二季度单季	约 20.82 亿元	未提供	约 6.11 亿元（归属于上市公司股东）	未提供
2025 年全年	52.92 亿元	+45.31%	13.31 亿元（归属于上市公司股东）	+190.42%

2026 年二季度单季数据为根据 2026 年半年度数据减去一季度数据计算所得；2026 年上半年扣非归母净利润为 9.22 亿元，同比增长 158.11%，基本每股收益为 1.52 元，同比增长 123.53%。

公司 2026 年上半年收入和利润保持高速增长，归母净利润增速明显高于收入增速。同期毛利率为 55.48%，同比上升 0.55 个百分点；销售净利率为 27.82%，同比上升约 8.15 个百分点；加权平均净资产收益率为 18.52%，上年同期为 11.96%。经营活动产生的现金流量净额为 3.33 亿元，上年同期为净流出 0.80 亿元。截至 2026 年 6 月 30 日，归属于上市公司股东的净资产为 56.30 亿元，较 2025 年末增长 18.92%，每股净资产约 8.90 元。

3.2 盈利预测

截至 2026 年 9 月 11 日，同花顺盈利预测页面显示近六个月内共有 9 家机构进行预测。机构平均预测区间为：2026 年归母净利润 20.45 亿至 25.25 亿元、EPS 3.17 至 3.98 元；2027 年归母净利润 28.38 亿至 36.84 亿元、EPS 4.47 至 5.71 元；2028 年归母净利润 39.33 亿至 54.73 亿元、EPS 6.20 至 8.48 元。单家机构预测包括：国金证券预计 2026 年至 2028 年营业收入为 78.14 亿、105.88 亿和 141.63 亿元，归母净利润为 20.63 亿、28.38 亿和 40.36 亿元，EPS 为 3.25 元、4.48 元和 6.36 元；广发证券预计营业收入为 78.71 亿、98.72 亿和 121.11 亿元，归母净利润为 23.62 亿、31.29 亿和 39.59 亿元，EPS 为 3.72 元、4.93 元和 6.24 元；方正证券预计营业收入为 82.84 亿、118.67 亿和 159.82 亿元，归母净利润为 22.53 亿、36.84 亿和 53.21 亿元，EPS 为 3.49 元、5.71 元和 8.24 元；东吴证券预计归母净利润为 20.45 亿、34.90 亿和 54.73 亿元，EPS 为 3.17 元、5.41 元和 8.48 元。上述数据均为机构预测，不是公司承诺。

年度	营业收入	归母净利润	净利润增速	每股收益(EPS)
2026 年（机构平均预测）	约 80.20 亿元	22.08 亿元（归母净利润）	较 2025 年实际值约+65.9%	3.46 元
2027 年（机构平均预测）	未提供	32.42 亿元（归母净利润）	较 2026 年机构平均预测约+46.8%	5.08 元
2028 年（机构平均预测）	未提供	43.96 亿元（归母净利润）	较 2027 年机构平均预测约+35.6%	6.88 元

3.3 估值水平与机构评级

机构	评级	日期	备注
国金证券	买入	2026 年 6 月 25 日	目标价 325.40 元；预测 2026 年至 2028 年 EPS 分别为 3.25 元、4.48 元和 6.36 元。
天风证券	持有	2026 年 7 月 16 日	目标价 328.25 元；预测 2026 年至 2028 年归母净利润分别为 22.35 亿、32.03 亿和 41.07 亿元。
方正证券	增持	2026 年 9 月 3 日	将 2026 年至 2028 年归母净利润预测上调至 22.53 亿、36.84 亿和 53.21 亿元，EPS 预测为 3.49 元、5.71 元和 8.24 元。
东吴证券	买入	2026 年 8 月 31 日	预测 2026 年至 2028 年归母净利润分别为 20.45 亿、34.90 亿和 54.73 亿元，EPS 分别为 3.17 元、5.41 元和 8.48 元。
华西证券	积极评级	未提供	中报点评中继续给予积极评级，具体评级及目标价未提供。

截至 2026 年 9 月 11 日收盘，股价为 257.70 元，当日下跌 4.02%，总市值约 1663.67 亿元，过去 52 周价格区间约为 58.74 元至 395.00 元。市盈率 TTM 约为 88.9 倍，不同行情终端披露的 PE 约为 87 倍至 90 倍。按同花顺 9 家机构平均 EPS 预测计算，2026 年至 2028 年前瞻 PE 分别约为 74.5 倍、50.7 倍和 37.5 倍。按 2026 年 6 月 30 日每股净资产约 8.90 元计算，静态市净率约为 29 倍；部分行情平台显示 PB 约 19 倍至 20 倍，存在净资产口径、股本处理方式及数据更新时间差异，PB 数据不确定。公开目标价为 325.40 元至 328.25 元，平均约 326.83 元，较 257.70 元理论上涨空间约 26.8%；但目标价样本较少，且主要基于 2026 年中期或更早信息，不能视为确定收益。当前估值较高，股价对测试机放量、存储设备需求、AI 芯片测试需求及盈利兑现速度较为敏感；若订单、需求或利润释放低于预期，估值可能面临压缩风险。

四、近期消息与公告

4.1 2026 年上半年业绩大幅增长，半年报基本兑现业绩预告

长川科技于 2026 年 6 月 23 日披露半年度业绩预告，预计 2026 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 9.00 亿元至 10.00 亿元，同比增长 110.76%至 134.18%；预计扣除非经常性损益后的净利润为 8.55 亿元至 9.55 亿元，同比增长 139.38%至 167.38%。2026 年 8 月 28 日披露的半年报显示，公司上半年实现营业收入 34.6079 亿元，同比增长 59.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.6367 亿元，同比增长 125.67%，处于业绩预告区间中部，业绩预告基本兑现。上半年研发费用为 2.6856 亿元，同比增长约 6.07%；经营活动产生的现金流量净额为-2.0937 亿元，主要因采购支出增长较快，后续需关注应收账款、存货及经营现金流变化。

4.2 2026 年半年度利润分配预案待股东会审议

公司于 2026 年 8 月 28 日披露 2026 年半年度利润分配预案，拟以 2026 年 6 月 30 日总股本 634,418,614 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本。按当时总股本静态测算，现金分红总额约 6,344.19 万元。该方案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东大会审议，股东会计划于 2026 年 9 月 14 日召开。截至 2026 年 9 月 13 日，方案尚未完成股东会最终审议。

4.3 向特定对象发行股票上市，募集资金净额约 30.92 亿元

公司 2025 年度向特定对象发行股票事项于 2026 年 8 月实施，发行人民币普通股 11,163,580 股，发行价格为 280.11 元/股，募集资金总额约 31.2703 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额约 30.9207 亿元。新增股份于 2026 年 8 月 7 日在创业板上市，限售期为自上市之日起 6 个月。募集资金主要用于半导体设备研发项目及补充流动资金，有利于支持研发和产能建设，但短期存在股本摊薄及募投项目收益释放滞后的风险。

4.4 控股股东持股比例因定增被动稀释

由于 11,163,580 股定增股份上市，公司控股股东赵轶持股比例由约 22.31%被动稀释至约 21.93%，触及 1 个百分点整数倍。该变化属于公司发行新股导致的被动稀释，不属于控股股东主动减持，不涉及要约收购，也未导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

4.5 一致行动人此前减持计划已实施完毕

公司于 2026 年 4 月 28 日披露，控股股东、实际控制人一致行动人杭州长川投资管理合伙企业（有限合伙）于 2026 年 4 月 1 日至 4 月 28 日期间通过大宗交易累计减持 7,009,600 股，占公司当时总股本约 1.00%，减持计划已实施完毕。此前减持计划为不超过 7,059,600 股，实际减持数量略低于计划上限。该事项并非 2026 年 9 月新发生事项。截至 2026 年 9 月 13 日，未发现新的股东减持计划公告。

4.6 收购长川制造 33.33%少数股权完成登记

公司通过上海联合产权交易所公开摘牌方式，受让国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持有的杭州长川智能制造有限公司 33.33%股权，交易价格为人民币 46,286.67 万元。公司于 2026 年 4 月 13 日签署产权交易合同，并于 2026 年 4 月 16 日一次性支付交易对价。根据 2026 年半年度报告，截至 2026 年 7 月 23 日，相关股权变更登记手续已完成。该交易有利于提高公司对长川制造的持股比例和控制程度，但占用现金规模较大，仍需关注后续盈利贡献及资金使用效率。

4.7 海外并购及增资布局 PYXIS

2026 年半年度报告披露，公司控股曾孙公司长超香港以合计 4,989.8024 万新加坡元的总价款受让 PYXIS CFPT. LTD 原股东合计 62.36%的股权，其中部分价款用于受让子公司 STI 持有的 PYXIS 6% 股权，并向 PYXIS 增资 600 万新加坡元。交易及增资完成后，公司间接持有 PYXIS 约 16.95%的股份，相关股权转让及增资已于 2026 年 4 月 23 日完成工商变更登记。该事项涉及海外业务及光学检测等产品布局，交易结构较复杂，解读应以半年报披露的合并口径为准。

4.8 限制性股票部分作废，不属于上市公司股份回购

公司于 2026 年 8 月 28 日披露《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》，公司第四届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 27 日审议通过相关议案，原因涉及部分激励对象不再符合归属条件等情况。具体作废数量应以公司公告正文及相关法律意见书披露数据为准。该事项属于股权激励计划调整，不是上市公司主动回购股票。截至 2026 年 9 月 13 日，未发现公司在 2026 年 6 月至 9 月 13 日期间披露新的股份回购方案、回购进展公告或回购注销公告。

4.9 部分募投项目延期并调整实施主体

公司于 2026 年 8 月 28 日披露 2023 年 8 月向特定对象发行股票部分募投项目延期公告，同时披露拟增加部分募投项目实施主体、使用自有资金或承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换等事项。公司拟增加北京、成都分公司作为“半导体设备研发项目”的共同实施主体。该调整未改变募集资金投向，不涉及募集资金用途变更，但部分项目存在延期，后续需关注延期后的完成时间、投资进度及项目收益兑现情况。

4.10 截至 2026 年 9 月 13 日未发现新增重大监管处罚及相关公告

截至 2026 年 9 月 13 日，本轮检索未发现长川科技新增的监管处罚、立案调查、交易所纪律处分或针对公司重大事项的监管问询公告；亦未发现 2026 年 9 月 1 日至 9 月 13 日期间披露新的回购公告或新的股东减持计划。2026 年 6 月至 9 月监管部门持续释放支持并购重组、鼓励上市公司做优做强及支持硬科技企业发展的政策信号，但目前没有证据表明长川科技已获得某项特定监管政策的直接审批或专项支持。

五、股价走势与技术面分析

5.1 价格概况

指标	数值
收盘价	257.70 元
当日涨跌	下跌 10.80 元，跌幅 4.02%
开盘价	264.11 元
日内高低价	最高 264.46 元，最低 250.00 元
成交量	166,227 手，约 1,662.27 万股
成交额	42.6653 亿元，约 42.67 亿元
换手率	3.40%
总市值/流通市值	总市值约 1,663.67 亿元，流通市值约 1,261.48 亿元
52 周价格区间	高点 395.00 元，低点 42.71 元；不同平台还出现 53.36 元低点，可能与复权、数据起止日期或行情口径有关

5.2 技术指标

指标	数值	简要解读
MA5/MA10/MA20	MA5 约 265.45 元，MA10 约 268.70 元，MA20 约 275.04 元	收盘价 257.70 元低于三条均线，且 MA5 低于 MA10、MA10 低于 MA20，短线均线呈偏弱排列。上述均线为基于 2026 年 8 月 17 日至 9 月 11 日公开收盘价的自行计算结果
MACD(12,26)	约-3.19，信号方向为卖出	DIF 与 DEA 关系偏弱，短线动能偏空；该数据来自第三方技术指标页面，未使用交易所原始指标接口复核，网页不同

指标	数值	简要解读
		抓取时点曾显示不同数值
RSI(14)	约 41.47	处于弱势区间，但尚未达到传统意义上的极端超卖区域
RSI6	约 39	基于最近 6 个价格变动的简单估算，短线动能偏弱，但距离通常所说的 30 以下极端超卖仍有一定距离；不同软件平滑算法可能导致结果不同
布林带	中轨约 275.04 元，上轨约 298.87 元，下轨约 251.22 元	收盘价接近布林下轨但尚未有效跌破；9 月 11 日盘中最低 250 元，略低于估算下轨，收盘重新回到下轨上方，250 元附近存在短线承接，但承接强度仍需后续成交量和收盘表现确认
价格行为与波动	2026 年 7 月 21 日涨停收盘 318.00 元；7 月 30 日跌 9.41%，8 月 3 日跌 12.41%；9 月 7 日涨 6.40%，9 月 11 日跌 4.02%	7 月下旬以来股价仍处高位区域，但日线波动率较高，多次出现大涨大跌，短线筹码交换较充分
主力资金	9 月 11 日净流出约 2.1975 亿元，占当日成交额约 5.15%；近 3 日累计净流出约 2.77 亿元	9 月 11 日放量下跌同时主力资金净流出，短线更接近放量分歧、资金撤出压力增加，而非明确的主动吸筹；主力资金统计受大单划分规则影响，不等同于全部机构资金流向
融资余额	截至 2026 年 9 月 10 日约 30.45 亿元，占流通市值约 1.79%至 2.34%，不同平台计算时点略有差异	融资资金规模存在平台口径差异，研究纪要未据此给出明确的单边趋势判断
估值参考	PE(TTM)约 89 倍，动态 PE 约 85 倍；不同数据源存在口径差异	估值数据口径不一致，本节不将市净率作为核心技术指标；市净率约 19.00 倍至 26.43 倍，受计算口径、总股本及净资产更新时点影响较大

截至 2026 年 9 月 11 日，长川科技收盘 257.70 元，日跌 4.02%，成交额 42.67 亿元，高于 9 月 8 日至 9 月 10 日约 27.25 亿至 36.32 亿元的成交额，但低于 9 月 1 日约 80.15 亿元和 9 月 4 日约 52.65 亿元的阶段性放量水平。股价低于 MA5、MA10 和 MA20，MACD 及 RSI 均显示短线动能偏弱；同时收盘价接近布林下轨约 251.22 元，盘中最低触及 250 元，250 元附近的支撑有效性成为短期观察重点。资金面上，9 月 11 日主力资金净流出约 2.20 亿元，近 3 日累计净流出约 2.77 亿元，当前更接近放量分歧状态。若后续反弹不能重新站上 265 至 270 元区域，短线仍偏弱势震荡；若放量站回 275 元附近，调整结构才可能获得一定修复。

5.3 短线走势展望（未来一周，情景推演，仅供参考）

⚠ 风险提示：以下内容仅为基于截至 2026 年 9 月 11 日收盘数据、历史价格和技术指标的主观情景推演，不构成投资建议，也不构成对未来走势的保证。

① 关键技术位置

位置	区间	说明
短期压力	265~270 元	对应 MA5 约 265.45 元、MA10 约 268.70 元及近期反弹后的密集成交区。若不能重新站上该区域，短线仍偏弱势震荡
强压力	274~286 元	对应 MA20 约 275.04 元、9 月 1 日至 9 月 4 日成交密集区及近期多次冲高回落区域。有效突破并站稳后，短线才可能进一步测试 298~305 元附近
第一支撑	250~255 元	参考 9 月 11 日最低价 250 元、9 月 4 日收盘价 254.23 元及布林下轨约 251.22 元。若 250 元附近获得承接并重新回到 260 元上方，可能形成弱势震荡结构；若有效跌破 250 元，下方可能考验 239~247 元
强支撑	239~247 元	参考 8 月 3 日、8 月 4 日前后形成的低位成交区域及前期波动密集区。若该区域也被放量跌破，短线调整空间可能进一步打开，但不能据此推断必然回到某一具体价格

② 未来一周情景（主权重，非统计概率）

- 震荡整理（相对权重较高，约六成左右；属于基于当前技术面和资金面的主观判断权重，不是统计概率）：股价运行于 250~275 元区间。触发条件包括 250~255 元支撑有效、成交额回落至约 25 亿~40 亿元的近期正常区间、股价重新站上 265 元但未有效突破 275 元，且半导体设备板块不出现持续性大幅下跌
- 偏弱下行（权重中等；属于基于当前技术面和资金面的主观判断权重，不是统计概率）：股价运行至 239~255 元区间。触发条件包括 250 元附近连续收盘失守、成交额放大但收盘继续走低、主力资金连续净流出且半导体设备板块同步走弱；失守 250 元后，短线可能向 239~247 元区域寻找支撑
- 反弹走强（权重偏低至中等；属于基于当前技术面和资金面的主观判断权重，不是统计概率）：股价反弹至 275~286 元，强势时测试 298 元附近。触发条件包括重新站回 265~270 元并连续收盘维持其上、放量突破 275 元及 MA20 附近压力、单日成交额明显高于近期均值且上涨时主力资金同步转为净流入，以及半导体设备、芯片或创业板成长风格出现板块共振。在没有放量突破 275~286 元之前，反弹更适合视作技术性修复

③ 资金与流动性背景

截至 2026 年 9 月 11 日，最近 5 个交易日换手率分别为 3.40%、2.12%、2.09%、2.76%和 3.52%，平均约 2.78%；最近 5 日成交额约 27.25 亿~45.98 亿元，平均约 35.98 亿元，9 月 11 日成交额 42.67 亿元，高于最近 5 日均值但未达到 9 月 1 日 80 亿元级别的极端放量。长川科技属于成交额较大的高市值创业板股票，日常交易流动性较好，但由于股价较高且近期波动幅度较大，快速下跌或快速拉升时仍可能出现较明显滑点。股东结构数据截至 2026 年 6 月 30 日：前十大流通股东合计持有约 1.07 亿股，占流通 A 股约 21.81%；股东总数为 120,196 户，较 2026 年 3 月 31 日增加 72.36%；同花顺

统计的机构持仓合计约 1.95 亿股，占流通 A 股约 39.91%，其中基金持仓约 30.92%，QFII 约 0.77%。前十大流通股东中包括香港中央结算有限公司、UBS AG 及多只半导体相关 ETF，显示存在公募基金、QFII 及 ETF 类机构持仓，但该数据距离 2026 年 9 月 11 日已有两个多月，且期间股价波动较大，当前筹码结构可能已经发生变化，不能直接代表实时机构仓位。前十大流通股东比例相对有限、股东户数增加，意味着流通筹码并非高度集中，短线价格可能更容易受到市场情绪、ETF 资金及高频交易资金影响。

可检查的成交量确认信号：若未来一周连续两个交易日成交额达到或超过 45 亿元，同时股价收盘站上 275 元，且主力资金由净流出转为净流入，可视为短线反弹获得资金确认的信号；若成交额放大至 45 亿元以上但股价仍收于 250 元下方，则更接近放量下跌或资金兑现信号。

④ 关注要点（仅为观察思路，非操作指令）

- 观察 250~255 元区域能否形成有效支撑，重点关注收盘价是否连续跌破 250 元。
- 观察 265~270 元能否重新站稳，这是短线修复的第一道确认位。
- 观察 275~286 元压力区是否出现放量突破，未突破前反弹仍偏技术性。
- 观察成交额是否连续达到 45 亿元以上，并与主力资金净流向同步改善。以上均为观察思路，非操作指令。

以上情景推演基于 2026 年 9 月 11 日收盘数据及历史价格、技术指标测算，短期股价还会受消息面、资金面、大盘环境、半导体板块表现及市场风险偏好等多重因素扰动，技术指标本身存在滞后性和局限性，不构成对未来实际走势的保证，也不构成买卖建议，请结合最新市场信息独立判断并自行承担投资风险。

六、行业格局与竞争对手分析

6.1 行业现状

长川科技所在的半导体测试设备行业处于半导体制造产业链中游偏后端，连接上游电子元器件、精密机械和工业软件，向下服务晶圆制造、封装测试和芯片设计企业。行业具有较高技术和客户认证壁垒，同时受到半导体资本开支、芯片库存及下游扩产节奏影响，呈现明显周期性。

6.2 竞争格局

- 全球半导体测试设备市场长期呈现较高集中度，测试机领域主要由美国泰瑞达（Teradyne）和日本爱德万测试（Advantest）等国际厂商占据较强地位，科休（Cohu）也覆盖测试、分选和封装测试设备。
- 长川科技 2020 年审核问询回复援引 SEMI 数据称，2017 年全球测试机市场前两家企业泰瑞达和爱德万合计份额达到 87%。该数据较早，不能直接代表 2025—2026 年的最新市场份额，仅能说明行业技术和客户集中度较高的历史特征。
- 中国市场主要趋势包括国内晶圆制造和封装测试产能扩张、国产替代推进，以及国产设备在价格、交付、服务和本地化响应方面的优势。
- 国际厂商在高端产品、品牌和长期客户认证方面仍具有较强优势；国内企业在测试机、分选机、探针台和 AOI 等细分设备上各有突破。
- 行业壁垒主要体现为设备稳定性、测试精度、良率控制、客户认证周期、售后服务能力及与芯片工艺的协同开发，而非单纯生产设备数量。

6.3 主要竞争对手

公司	定位	说明
华峰测控（688200，科创	半导体自动化测试系	与长川科技测试机业务重叠度较高；华峰测控

公司	定位	说明
板)	统，重点覆盖模拟、混合信号、功率器件和 SoC 等测试领域。	在模拟及功率测试机领域积累较深。
金海通（603061，沪市主板）	集成电路测试分选机，重点覆盖封装测试环节。	与长川科技分选机业务重叠度较高；金海通更偏向分选机细分赛道，长川科技产品覆盖测试机、分选机、探针台和 AOI。
联动科技（301369，创业板）	半导体自动化测试系统和激光打标设备，主要应用于功率器件、模拟芯片等领域。	与长川科技在测试机及功率器件测试方面存在竞争关系，但整体规模和产品覆盖范围相对较窄。
华兴源创（688001，科创板）	半导体测试领域提供测试机、分选机等设备，覆盖 SoC、存储、射频等芯片测试需求，同时涉及显示检测设备。	业务更加多元，显示检测业务权重较高；半导体测试是其重要增长方向之一。
精测电子（300567，创业板）	传统优势为平板显示检测设备，近年来向半导体测试和检测设备拓展，涉及半导体检测设备、分选机等产品。	与长川科技存在部分产品和客户重叠，但核心历史优势仍在显示检测领域，属于部分可比而非完全同质化竞争对手。
泰瑞达（Teradyne）	全球领先的半导体测试机企业，强项为高端 ATE 测试系统。	在高端技术、全球客户认证、品牌和长期工艺协同方面具有优势。
爱德万测试（Advantest）	全球主要测试机厂商，覆盖 SoC、存储和高端逻辑芯片测试。	在高端测试机及全球客户认证方面具有较强竞争力。
科休（Cohu）	覆盖测试机、分选机、接触器和封装测试设备。	在测试、分选和封装测试设备领域具有竞争力。

长川科技相较华峰测控更强调测试机、分选机、探针台和 AOI 的综合产品布局；相较金海通，其业务不局限于分选机；相较联动科技和精测电子，产品覆盖和半导体测试设备平台化程度更高。与泰瑞达、爱德万测试和科休等国际厂商相比，公司在高端技术、全球客户认证、品牌和长期工艺协同方面仍存在差距，核心机会在于中国大陆市场国产替代、快速服务、本地化交付及产品线完整性。

七、风险提示

- 下游客户和收入集中度较高。2025 年前五大客户销售金额占年度销售总额 57.66%，最大客户占 22.79%；应收账款和合同资产前五名客户占比进一步达到 64.09%。若主要客户扩产节奏放缓、验收或回款延迟，可能对收入确认、现金回收和营运资金形成压力。

- 半导体设备需求具有明显周期性。公司下游覆盖晶圆制造、封装测试和芯片设计企业，收入和利润依赖半导体资本开支、芯片库存及扩产节奏；若行业景气度回落，测试机、分选机等核心产品订单可能出现波动。
- 测试机业务存在产品结构和毛利率波动风险。2025 年测试机毛利率为 62.25%，同比下降 4.36 个百分点，资料指出主要与产品结构变化及部分模拟类产品占比提升有关。若高毛利高端测试机放量不及预期，综合毛利率和利润增速可能承压。
- 公司对关键电子元器件、精密机械件、视觉系统、运动控制和温控系统等存在一定供应链依赖。2025 年直接材料占主营业务成本 81.26%，按营业成本口径占比 89.86%；若关键部件价格上涨、交付延迟或替代验证不顺利，可能影响生产成本和交付进度。
- 产能利用率存在下滑迹象。2025 年按集成电路电子工业专用设备整体口径披露的产能利用率为 82.79%，低于 2024 年的 96.35%，且年报未拆分测试机、分选机及 AOI 等产品的独立产能。若新基地和募投项目投产后订单增长不足，可能出现产能利用率不足及固定成本摊薄压力。
- 并购、增资及募投项目存在执行风险。公司完成长川制造 33.33% 少数股权收购并布局 PYXIS，同时部分募投项目延期并调整实施主体；若项目进度、整合效果或盈利贡献不及预期，可能造成资金使用效率下降、商誉或投资收益不达预期等压力。
- 定向增发带来股本摊薄和限售股解禁压力。2026 年 8 月新增 11,163,580 股，募集资金净额约 30.92 亿元，新增股份限售期为上市之日起 6 个月；若募投项目收益释放滞后，短期可能面临每股收益摊薄及潜在供给增加的影响。
- 当前估值和股价波动风险较高。截至 2026 年 9 月 11 日，股价 257.70 元，市盈率 TTM 约 89 倍，且股价低于短期及中期均线，9 月 11 日主力资金净流出约 2.20 亿元。若订单、利润或市场风险偏好低于预期，可能出现估值压缩和较大幅度价格波动。

八、结论与展望

公司基本面仍处于较强增长阶段，2026 年上半年利润增速显著高于收入增速，测试机放量、分选机结构改善、国产替代推进及研发和产能投入，构成中期业绩延续的主要支撑。机构平均预测 2026 年归母净利润约 22.08 亿元，2027 年和 2028 年分别约 32.42 亿元和 43.96 亿元，但上述数据属于机构预测，并非公司承诺，未来兑现程度取决于下游资本开支、订单交付、客户认证和产品结构变化。

公司后续需要重点验证高端测试机持续放量、分选机毛利率改善、探针台及 AOI 等新业务贡献，以及高端智能制造基地和募投研发项目的产能利用率与收益释放。当前客户集中度较高，2025 年前五大客户销售占比 57.66%，且最大客户占 22.79%；同时估值较高，市场对业绩增长和盈利兑现已有较充分预期，增长不及预期时估值压缩敏感度较高。

短期股价处于技术调整阶段，后续表现可能在基本面增长与高估值、资金分歧之间反复博弈。分析公司经营质量时，还需持续跟踪应收账款及合同资产集中度、存货和经营现金流变化；现有资料对 2026 年上半年经营活动现金流净额存在不同披露口径，分别显示为 3.33 亿元和净流出 2.09 亿元，因此相关数据应以正式半年度报告及后续公告核验。

数据来源

杭州长川科技股份有限公司简介_长川科技(300604)公司简介_证券之星 —

https://stock.quote.stockstar.com/corp/brief_300604.shtml?utm_source=openai

<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224752168.PDF> — <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224752168.PDF>

<https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225193261.PDF> — <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225193261.PDF>

<https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ea20ff71-0300-4078-8b58-93c0385ea2ac.PDF> —
<https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ea20ff71-0300-4078-8b58-93c0385ea2ac.PDF>

长川科技(300604)_公司公告_长川科技: 2024 年年度报告新浪财经_新浪网 —
https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=11057022&stockid=300604&utm_source=openai

证券简称: 长川科技 证券代码: 300604 —
https://crm.htsc.com.cn/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK/2020/2020-11/2020-11-20/6735365.pdf?utm_source=openai

天津金海通半导体设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 —
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-31/1225447823.PDF?utm_source=openai

公司公告_首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书新浪财经_新浪网 —
https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=10773007&stockid=&utm_source=openai

长川科技(300604)_公司公告_长川科技: 2026 年半年度报告摘要新浪财经_新浪网 —
https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12563972&stockid=300604&utm_source=openai

长川科技: 2026 年半年度报告_股票频道_证券之星 — [https://stock.stockstar.com/notice/SN2026082800005630.shtml?](https://stock.stockstar.com/notice/SN2026082800005630.shtml?utm_source=openai)
[utm_source=openai](https://stock.stockstar.com/notice/SN2026082800005630.shtml?utm_source=openai)

长川科技(300604): 25 年业绩超预期 助力国产算力__新浪财经_新浪网 —
[https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/830538780302/index.phtml?](https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/830538780302/index.phtml?utm_source=openai)
[utm_source=openai](https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/830538780302/index.phtml?utm_source=openai)

长川科技(300604)_财务分析_证券之星 — [https://stock.quote.stockstar.com/finance_300604.shtml?](https://stock.quote.stockstar.com/finance_300604.shtml?utm_source=openai)
[utm_source=openai](https://stock.quote.stockstar.com/finance_300604.shtml?utm_source=openai)

长川科技(300604) 盈利预测_F10_同花顺金融服务网 — [https://basic.10jqka.com.cn/48/300604/worth.html?](https://basic.10jqka.com.cn/48/300604/worth.html?utm_source=openai)
[utm_source=openai](https://basic.10jqka.com.cn/48/300604/worth.html?utm_source=openai)

国金证券: 给予长川科技买入评级, 目标价 325.4 元 — [https://stock.10jqka.com.cn/20260625/c677719573.shtml?](https://stock.10jqka.com.cn/20260625/c677719573.shtml?utm_source=openai)
[utm_source=openai](https://stock.10jqka.com.cn/20260625/c677719573.shtml?utm_source=openai)

长川科技(300604)2026 年中报点评: 业绩高速增长 测试机龙头充分受益于 SOC&存储共振__新浪财经_新浪网 —
[https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rptid/841506891578/index.phtml?](https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rptid/841506891578/index.phtml?utm_source=openai)
[utm_source=openai](https://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rptid/841506891578/index.phtml?utm_source=openai)

机构评级|天风证券给予长川科技 “持有” 评级 — [https://stock.10jqka.com.cn/20260716/c678218378.shtml?](https://stock.10jqka.com.cn/20260716/c678218378.shtml?utm_source=openai)
[utm_source=openai](https://stock.10jqka.com.cn/20260716/c678218378.shtml?utm_source=openai)

Hangzhou Chang Chuan Tech Stock Price History (300604) - Investing.com Canada —
https://ca.investing.com/equities/hangzhou-chang-chuan-tech-historical-data?utm_source=openai

長川科技(300604.SZ) 走勢圖 - Yahoo 股市 — https://tw.stock.yahoo.com/quote/300604.SZ?utm_source=openai

长川科技(300604)财务指标_新浪财经_新浪网 —
https://money.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vFD_FinancialGuideLine/stockid/300604/ctrl/2026/displaytype/4.phtml?utm_source=openai

深圳证券交易所创业板上市公司列表 — https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E8%AF%E5%88%B8%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%89%80%E5%88%9B%E4%B8%9A%E6%9D%BF%E4%B8%8A%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%88%97%E8%A1%A8?utm_source=openai

证券代码: 300604 证券简称: 长川科技 公告编号: 2026-032 — https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-06-23/1225381361.PDF?utm_source=openai

长川科技(300604)_公司公告_长川科技：2026年半年度报告新浪财经_新浪网 —
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12563971&stockid=300604&utm_source=openai

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2026-054 — https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225523200.PDF?utm_source=openai

公司公告_长川科技：2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书新浪财经_新浪网 —
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12478990&utm_source=openai

长川科技：杭州长川科技股份有限公司关于控股股东因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告_股票频道_证券之星 — https://stock.stockstar.com/notice/SN2026080500033694.shtml?utm_source=openai

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2026-027 — https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225261541.PDF?utm_source=openai

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2026-046 — https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225523210.PDF?utm_source=openai

杭州长川科技股份有限公司2026年半年度报告全文 —
https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/df60c9ec-07cc-4c91-bfa5-7b40801df61b.PDF?utm_source=openai

公司公告_长川科技：2026年半年度报告新浪财经_新浪网 —
https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12563971&stockid=&utm_source=openai

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2026-053 — https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225523216.PDF?utm_source=openai

市场监管总局部署开展经营者集中反垄断监管效能提升专项行动 —
https://www.samr.gov.cn/xw/sj/art/2026/art_e983d2203d7e4fffb98e3295a15fee4.html?utm_source=openai

长川科技(300604)_股票行情,行情首页_中财网 — https://quotedx.cfi.cn/quote37262_300604.html?utm_source=openai

长川科技(300604) - 历史交易数据 | 打板客网 — <https://dabanke.com/hangqing-300604.html>

Hangzhou Chang Chuan Tech (300604) Stock Forecast & Price Target - Investing.com —
https://www.investing.com/equities/hangzhou-chang-chuan-tech-consensus-estimates?utm_source=openai

Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd 股票技术分析 (300604) — https://hk.investing.com/equities/hangzhou-chang-chuan-tech-technical?utm_source=openai

长川科技(300604)_资金流向_证券之星 — https://stock.quote.stockstar.com/capital_300604.shtml?utm_source=openai

长川科技(300604)_公司公告_长川科技：2026年半年度报告摘要新浪财经_新浪网 —
https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12563972&stockid=300604&utm_source=openai

本报告由AI基于公开渠道信息自动检索、整理并生成，信息截至截至2026年9月11日收盘；技术指标及资金数据以研究纪要披露的相应日期和计算口径为准，可能存在时效性差异，具体数据请以公司正式公告及权威数据终端为准。本报告仅为信息整理与研究参考，不构成任何投资建议，投资者应独立判断并自行承担投资风险。